

The background of the slide is a close-up, top-down view of a silicon microchip. The chip is divided into a grid of numerous small, square dies. Each die has a complex, intricate pattern of circuitry. The colors are primarily blue and purple, with some yellow and green highlights, suggesting different layers or materials. Two prominent, thick white curved lines sweep across the image, one from the top left towards the center, and another from the bottom left towards the right, framing the central text.

Investor
Relations
2026

Creating a sustainable future through Reliable Technology



Disclaimer

본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 케이엔제이(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

Creating a sustainable future through Reliable Technology

최첨단 반도체 공정 부품과 자동화 솔루션으로
미래를 선도하는 혁신기업 **케이엔제이**

Bulk CVD SiC

Coated CVD SiC

Si & Ceramic

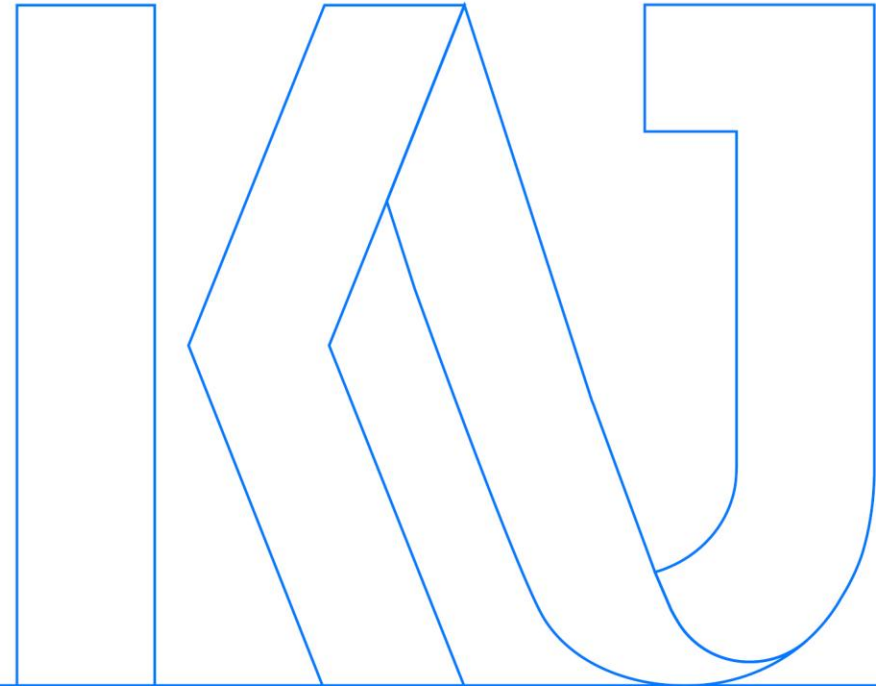


TABLE OF CONTENTS

Prologue

1. KNJ's Core Competitiveness

2. Business Performance

3. Growth Strategy

Appendix



Creating a sustainable future through Reliable Technology

Prologue

01. KNJ Overview
02. After Market 공급 구조
03. A/M 시장 성장성
04. 전방 수요 모멘텀
05. Investment Highlights

CVD SiC 기술 기반, 반도체 공정 핵심 소모성 부품 제조 기업

Core Business



CVD SiC 식각공정 부품

CVD SiC Focus Ring 중심의
반도체 식각공정용 핵심 소모성 부품 생산

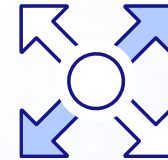
Market Position



A/M 시장 선도 지위

국내 주요 고객사향 양산 레퍼런스와
고객사 직접 대응 기반 공급 모델 확보

Business Expansion



신규 연결 사업 기반 외형 확장

FPCB 등 신규 연결 사업 편입으로
매출 기반 확대 및 성장동력 다변화 추진

02. After Market 공급 구조



B/M과 A/M 공급 구조 비교

	Before Market	After Market
시장 특징	<p>장비사 경우 공급 구조</p> <p>장비 표준 사양 기반 공급</p> <p>*고객사별 공정 조건 변화에 대해 직접 대응 제한</p>	<p>고객사 직접 공급 구조</p> <p>운전 데이터 기반 맞춤 스펙 대응</p> <p>*공정별 맞춤 대응 및 실사용 데이터 축적을 통한 제품 고도화</p>
부품 커스터마이징	제한적	매우 우수
실적 영향	신규 장비 발주량 연동	Fab 가동률, 소모품 점유율 연동
가격	A/M 대비 비쌈	B/M 대비 20% 저렴
주요 기업	티씨케이, 하나머티리얼즈, 한솔아이원스	케이엔제이, 씨엠티엑스, 윌텍스, 비씨엔시, 디에스테크노
단가 협상 구조	장비사가 칩 제조사 협상 후 부품업체들과 단가 논의	칩 제조사와 직접 협상

03. A/M 시장 성장성

A/M 침투율 확대에 따른 구조적 성장



A/M 시장의 특징

“ **업황 변동에도 안정적인 교체수요 기반 성장** ”



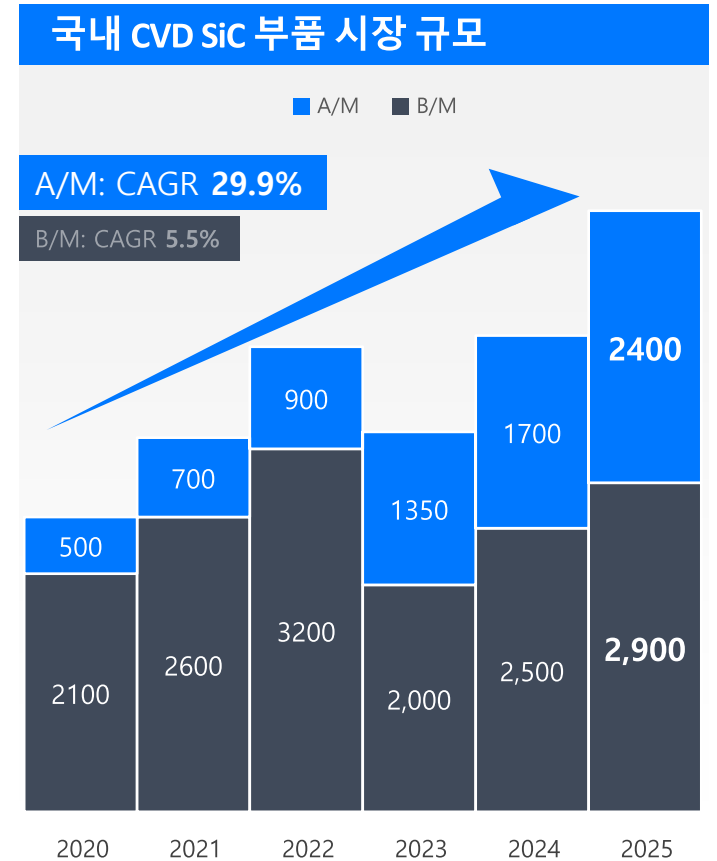
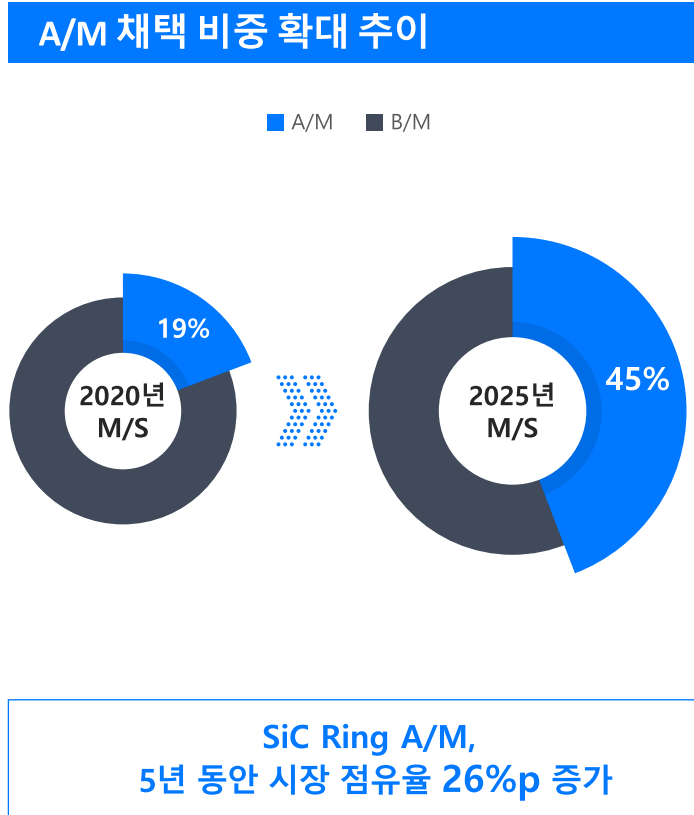
호황기

가동률 상승에 따른 교체 수요 확대



불황기

공정 효율화 및 원가 절감 니즈에 따른 수요 확대



자료 : 공시자료 기반 자체 추정

04. 전방 수요 모멘텀

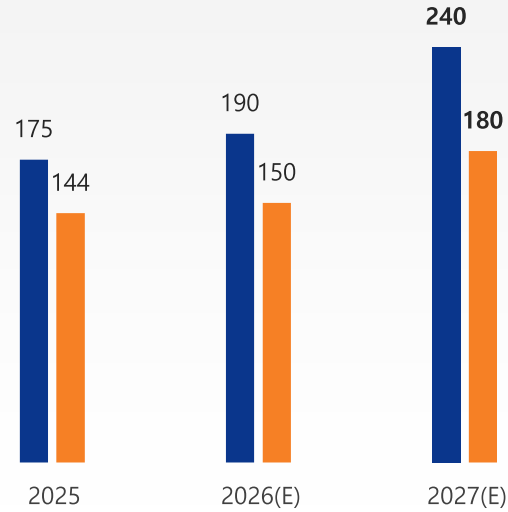
메모리 가동률 상승에 따른 교체수요 성장



국내 주요 메모리 고객 CAPA 확대

· 전체 메모리 생산능력 전망 추이 ·

■ 삼성전자 ■ SK하이닉스 단위: 만장/월

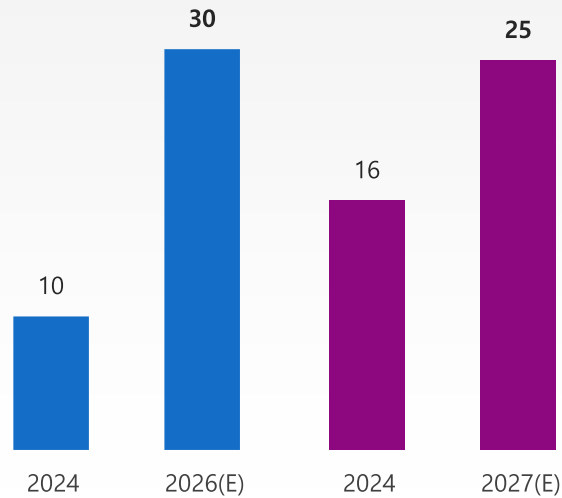


자료 : 각 사 자료 취합

중국 로컬 메모리 생산능력 확대

· 월간 웨이퍼 생산능력 전망치 ·

■ CXMT ■ YMTC 단위: 만장/월



자료 : 각 사 자료 취합

케이엔제이 부품 사업 성장 원동력

반도체 메모리 업황 회복



Fab 가동률 상승



식각 장비 가동시간 증가



SiC Focus Ring 교체수요 확대



부품사업 매출 성장

05. Investment Highlights



01 Market Leadership

A/M **No.1**

SiC Focus Ring
A/M 시장 선도

CVD SiC Focus Ring 기반
국내 주요 반도체 고객사향
양산 레퍼런스를 확보하며
A/M 시장 내 선도 지위 구축

02 Structural Growth

A/M **CAGR 29.9%**

A/M 채택 확대에 따른
구조적 수요 성장

고객사 직접 대응, 원가 효율화 니즈,
반복 교체수요를 기반으로
After Market 침투율 확대

03 Capacity Expansion

CAPA **1,400억 원**

A/M 수요 확대에 맞춘
CAPA 확장 대응

A/M 채택 확대와
고객사 물량 증가에 맞춰
신규 부지 확보 및 설비 확충을 추진,
중장기 매출 성장에 필요한
양산 기반을 단계적으로 확대

04 Revenue Scale-up

연결매출 확대

본업 성장과 신규 연결 효과
기반 외형 성장 본격화

SiC 부품사업의 성장 지속에 FPCB 등
신규 연결 사업 효과가 더해지며
연결 기준 매출 기반 확대



Creating a sustainable future through Reliable Technology

1. KNJ's Core Competitiveness

01. 커스텀 부품 대응 역량
02. 장비사업 노하우 기반 제조공정 최적화 역량
03. CAPA 확장 대응력
04. 선단 공정 대응력
- 05.. SiC 부품사업 매출 성장 추이

01. 커스텀 부품 대응력

고객사별 공정 조건에 대응하는 맞춤형 부품 개발 역량



02. 장비사업 노하우 기반 제조공정 최적화 역량

자체 CVD 챔버 제작과 가공공정 자동화를 통해 품질·원가·CAPA 경쟁력 강화

외부 장비 의존도 축소 및
설비 투자 효율 제고

장비 자체 설계·제작

수율 및 품질 안정화

소재 생산 공정 개선을 통한
수율 안정화 및 원가 경쟁력 강화

고객사 수요 변화에 맞춘
CAPA 증설 탄력성 확보

CAPA 증설 유연성

가공 자동화

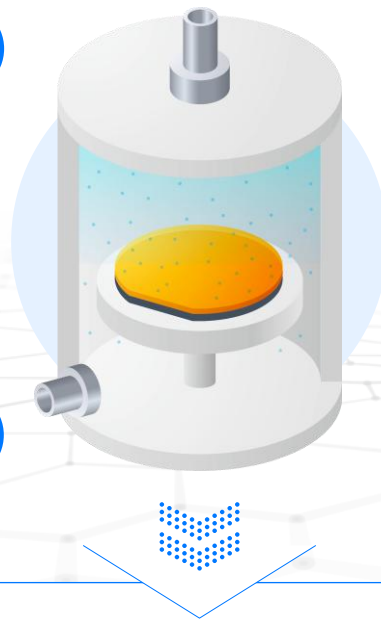
가공공정 자동화를 통한
생산성 향상 및 원가 절감

고객사 요구 스펙별 증착 조건
최적화 및 품질 균일성 확보

증착 공정 최적화

응용제품 확장 기반

CVD 증착 노하우를 활용한
응용 제품 개발 기반 확보

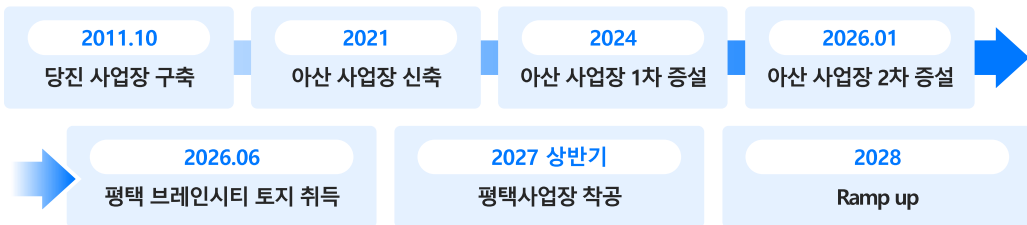


장비사업에서 축적한 제작·자동화 역량이 SiC 부품사업의 원가경쟁력으로 전환

03. CAPA 확장 대응력

수요를 기반으로 한 CAPA 확장을 통해 물량 증가 대응

CAPA 증설 로드맵



사업장 현황



아산 사업장 (본사)

- 주소: 충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22
- 면적: 17,461m² (5,300평 부지)
- 주요 제품: SiC 양산 중심



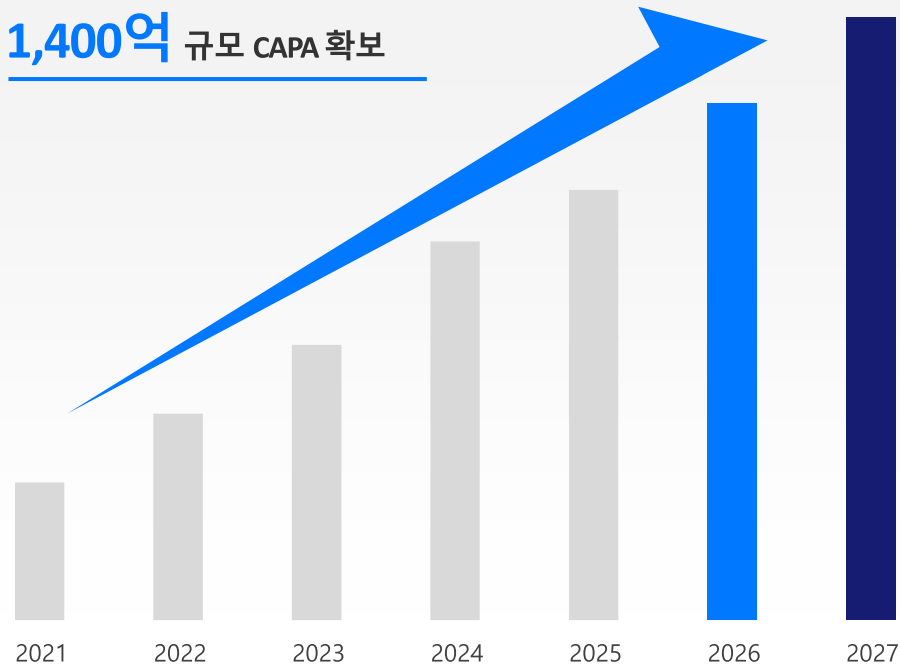
당진 사업장

- 주소: 충남 당진시 부곡공단4길 53-65
- 면적: 8,264m² (2,500평 부지)
- 주요 제품: SiC 양산, R&D 핵심 사업장

생산능력 추이

연 매출 환산

1,400억 규모 CAPA 확보



04. 선단 공정 대응력

공정 고도화에 따른 고사양 SiC 부품 수요 대응

HBM · DRAM 선단공정 확대와
NAND 고단화로 식각 환경 가혹화



고플라즈마 환경에서 Focus Ring의
내마모성 · 두께 균일도 · 품질 안정성 요구 확대



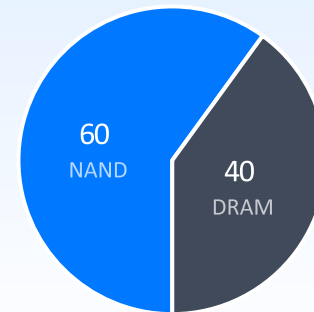
KNJ는

고객사별 커스텀 대응력과
자체 CVD 챔버 기반 공정 최적화 역량을 바탕으로
선단 공정향 고사양 SiC 부품 수요에 대응



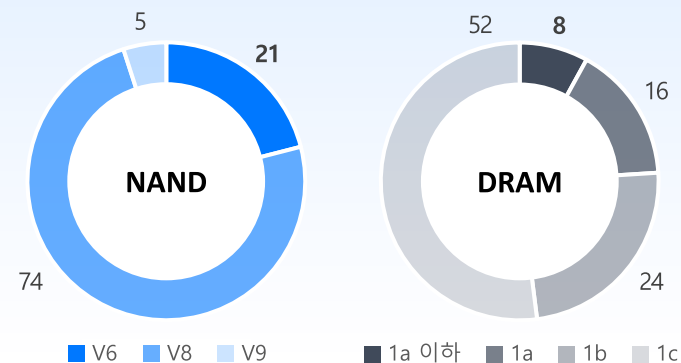
Application별 공급 비중

단위 : %



공정별 공급 비중

단위 : %



05. SiC 부품사업 매출 성장 추이

차별화된 핵심 역량 기반 SiC 부품사업 10년간 연평균 35.8% 성장 중

부품사업 매출액 추이 단위: 억 원

CAGR
35.8%





Creating a sustainable future through Reliable Technology

2. Business Performance

- 01. 경영 성과 - 2026년 1분기
- 02. 부품사업 성과 - 견조한 고객 수요
- 03. FPCB사업 성과 - 안정적인 전장향 매출
- 04. 성과 분석 - 재무 현황

01. 경영 성과 – 2026년 1분기

매출 규모와 수익성이 동반 확대되며 2026년 1분기 성장세 지속



Key Points



안정적인 내수 성장과
해외 매출 고성장 본격화

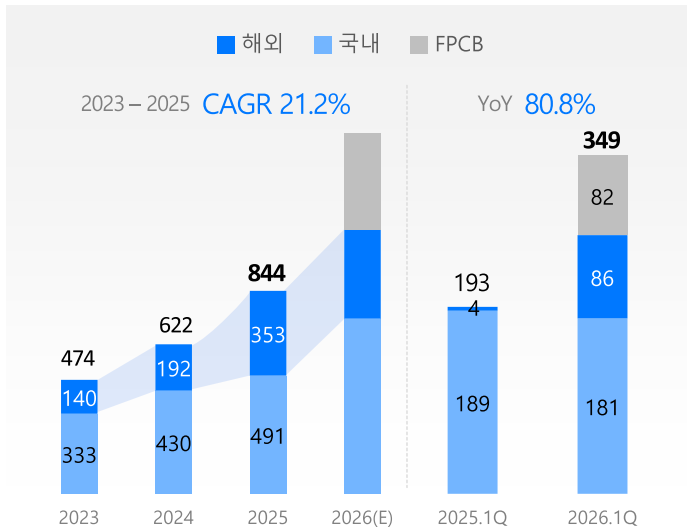


핵심 공정 내재화 기반
영업이익 지속 성장중

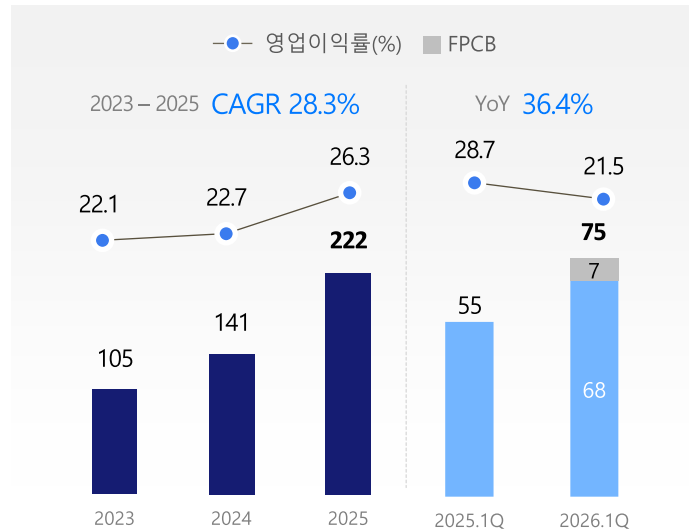


당기순이익
YoY 지속 성장중

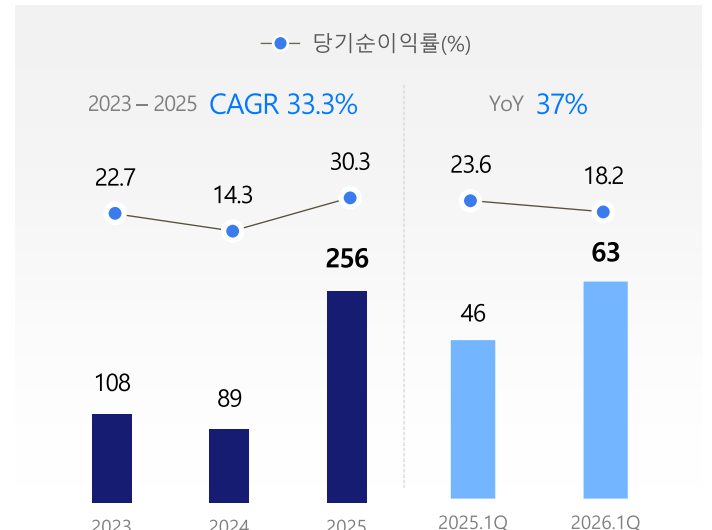
매출액 단위: 억 원



영업이익 단위: 억 원



당기순이익 단위: 억 원



자료: IFRS 연결 기준

02. 부품사업 성과 - 견조한 고객 수요

고객사 물량 증가와 생산실적 확대로 확인되는 본업 성장

Key Points



주요 고객사 중심의
견조한 수요 기반

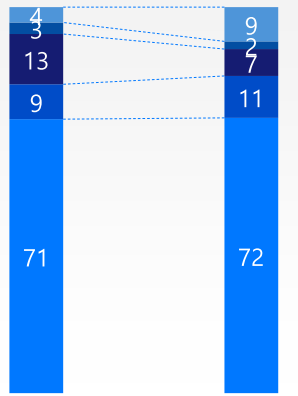


생산실적 및
가동률 지속 증가



DRAM 공급 확대에 이어
NAND 업황 회복 수혜 기대

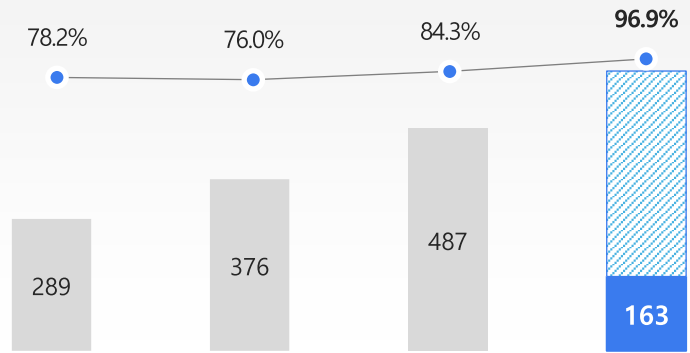
고객사별 공급 비중



2025 2026.1Q

생산 실적 추이

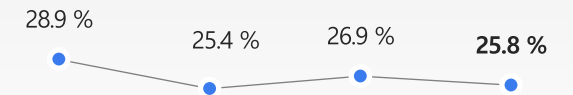
■ 생산실적 ● 가동률



2023 2024 2025 2026.1Q

OPM

● 부품사업 영업이익률



2023 2024 2025 2026.1Q

03. FPCB사업 성과 – 안정적인 전장향 매출

전장 중심의 안정적 매출 기반, 하반기 수익성 개선 기대



Key Points



1분기 일시적
매출 공백 발생



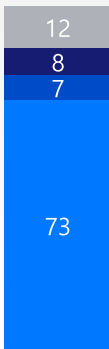
전장, EV 중심
건조한 실적 상승 전망



하반기 매출 및
수익성 개선 기대

제품별 매출 비중

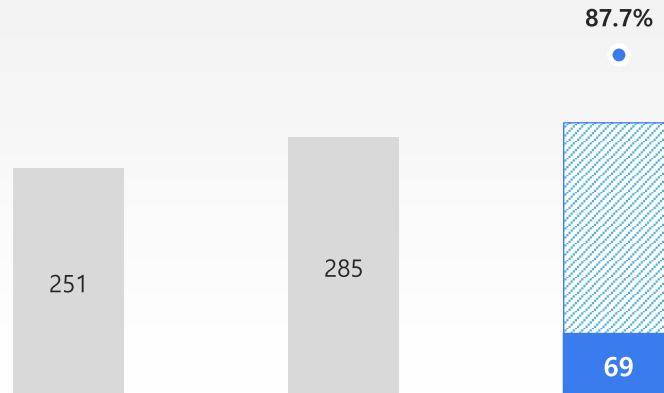
■ 전장 ■ EV
■ Display ■ 기타



2026.1Q

생산 실적 추이

■ 생산실적 ● 가동률



2024

2025

2026.1Q

OPM

● FPCB 사업 영업이익률

7.0 %

상반기

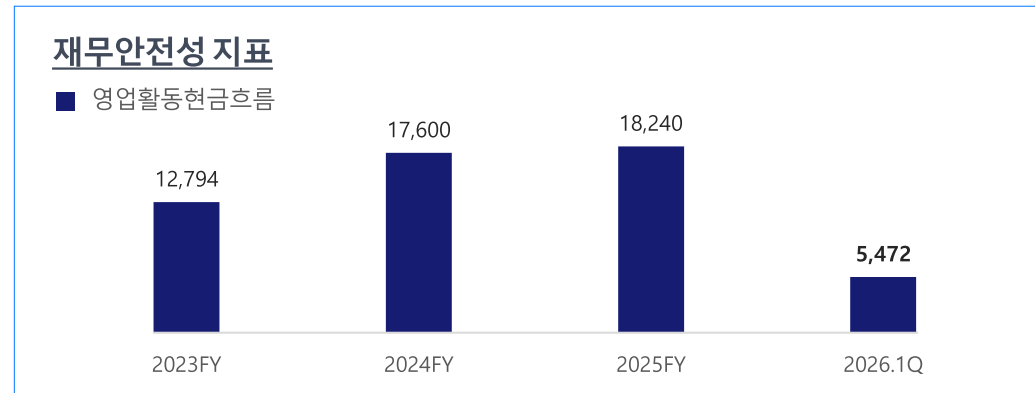
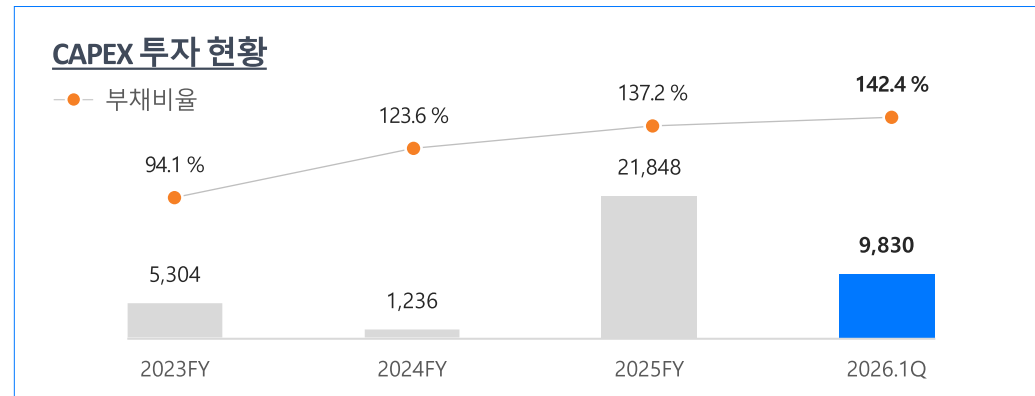
하반기

04. 성과 분석 - 재무 현황

CAPA 선제 투자와 신규 자회사 편입 효과로 자산·부채 규모 확대



주요 재무 지표 단위: 백만 원



자료 : IFRS 연결 기준
 - 부채비율(부채총계/자본총계), 2025년 온기 기준
 - 차입금비율: 총차입금(단기/장기차입금+유동성장기부채+리스부채)/자산총계

재무상태표 단위: 백만 원

구분	2023년	2024년	2025년	2026.1Q
자산총계	126,397	154,909	230,504	251,490
현금 및 현금성 자산 등	17,803	15,599	15,530	10,441
부채총계	61,267	85,626	133,311	147,751
총차입금	46,897	61,608	110,034	77,051
자본총계	65,129	69,282	97,192	103,738
유형자산	53,919	61,479	84,566	90,595
무형자산	2,758	2,832	46,804	48,101

**주요
변동 요인**

CAPEX 확대

CAPA 확보를 위한 생산설비 투자 증가

영업활동 현금흐름 증가

영업이익 확대 기반의 안정적인 현금 유입 지속

연결 편입 효과

써킷플렉스 편입에 따른 자산·부채 증가

자료 : IFRS 연결 기준



Creating a sustainable future through Reliable Technology

3. Growth Strategy

- 01. 성장 로드맵
- 02. 글로벌 중심 성장 가속화
- 03. 부품 사업 고도화 – 소재 R&D 강화
- 04. Next Chapter – FPCB 사업 진출

01. 성장 로드맵

해외 매출·소재·신사업 확대를 통한 중장기 성장 로드맵 구축

지속적인 성장동력 확보



FPCB 신사업, 고부가 소재,
해외 고객 기반으로
성장 포트폴리오 확대

>>>



<p>전장·EV FPCB 시장 진입 RTR 기반 대면적 FPCB로 전장·EV 시장 선점</p>	 EV용 BMS FPCB	 Display FPCB
<p>소재 포트폴리오 다각화 Graphite·대구경 Si·TaC 중심 고부가 소재 라인업 확대</p>	 Si 소재 부품	 Coating 제품
<p>해외 매출 성장 본격화 현지 고객 점점 확대를 통해 해외 매출 성장과 추가 수주 강화</p>	 CVD SiC Ring	 SH / URG

02. 글로벌 중심 성장 가속화

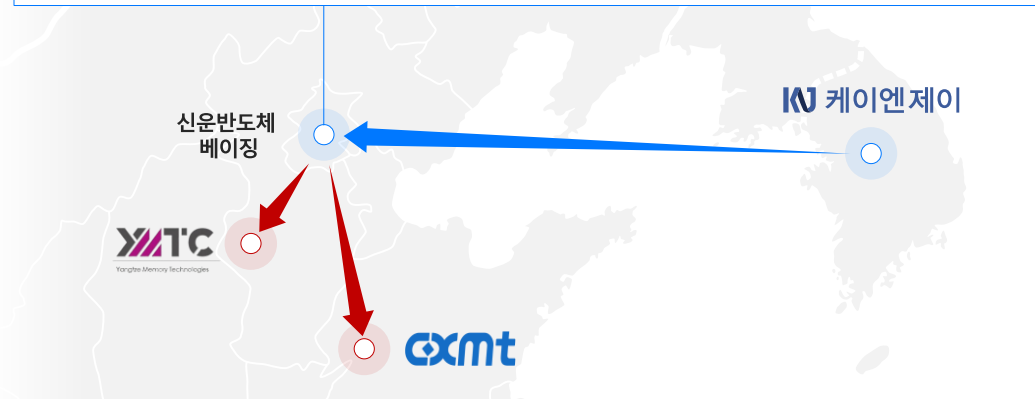
현지 JV 기반 고객 점점 확대로 해외 매출 성장 가속



중국 합작 법인 설립으로 해외 시장 침투 가속

KJ 케이엔제이

- 베이징 JV '신운반도체' 설립으로 현지 고객 점점 확보
- 중국·대만 반도체 FAB향 제품 공급 확대 중



현지 JV를 통한 글로벌 시장 대응력 강화

KJ 케이엔제이

핵심 공정 수행 후
반제품 공급



신운반도체

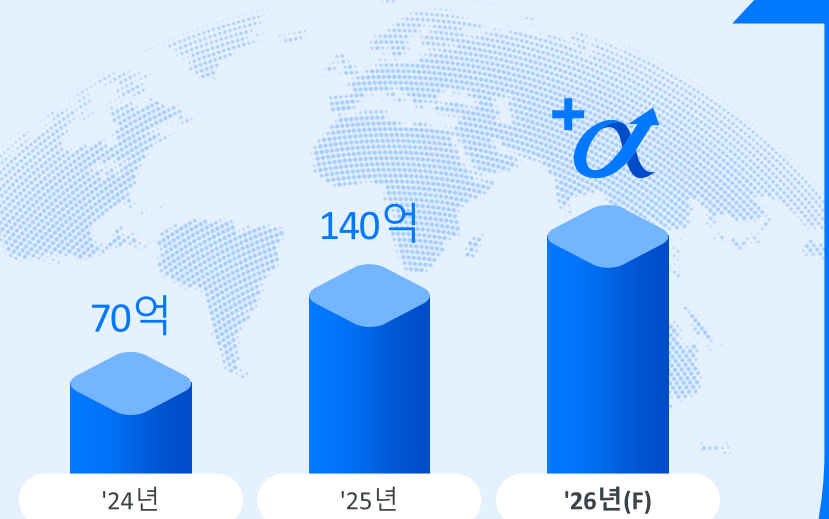
현지 완제품화
영업망 활용



YMTC SMIC
Exmt NAURA

현지 반도체 제조사에
납품 및 대응

· 해외 매출 성장 목표 ·



※ 국내 고객사의 해외법인 매출을 제외한,
현지 법인 고객사 대상 매출 기준

JV를 통한
현지 대응력

03. 부품 사업 고도화 – 소재 R&D 강화

소재·부품 포트폴리오 확대로 신성장 동력 강화



Si 부품

단결정 Si 소재 특성 활용

- 결정립계 최소화에 따른 Particle 발생 리스크 저감
- 고순도·균일성 기반 공정 안정성 향상
- 고부가가치 Si 부품 사업 확대
- Si Grower 기반 소재 내재화 R&D
- 정밀 가공 기반 공정 부품 대응



세트 부품 수요 대응

- 공정별 관련 부품 패키지 공급
- 고객사 구매 편의성 제고
- 부품 소싱·관리 효율과 세트 단위 품질 관리 용이
- 공정별 패키지 공급 확대



SiC 부품 다변화

- 내열성·내마모성 기반 고신뢰 부품 개발
- Showerhead, Boat 등 핵심 공정 부품 적용
- CVD SiC 노하우 기반 응용 제품군 확대
- 차세대 코팅 기술 (TaC 등) 개발 병행

04. Next Chapter – FPCB 사업 진출

써킷플렉스 편입으로 전장·EV 중심 대면적 FPCB 시장 대응 기반 확보



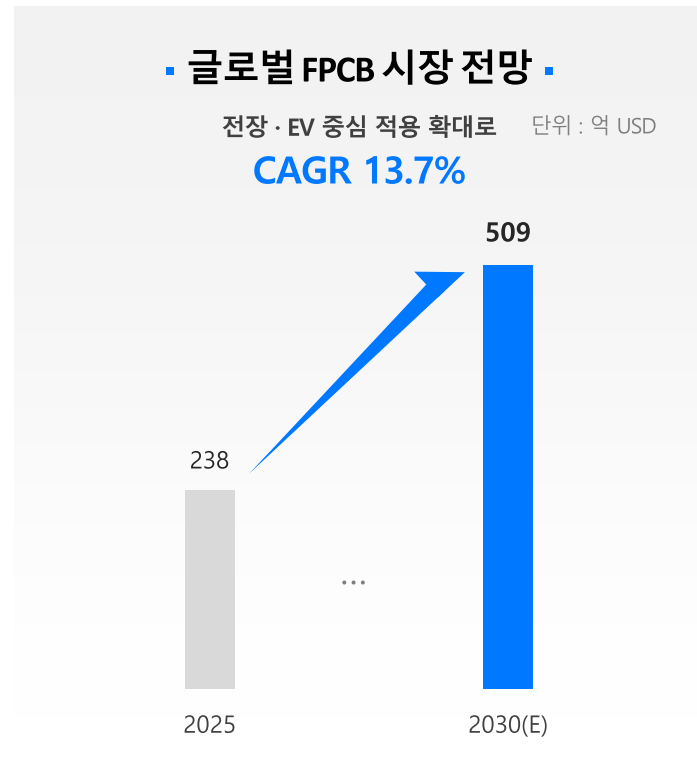
모바일 중심에서 전장·EV 중심으로 확대되는 FPCB 적용처

FPCB란?
유연한 기판 위에 회로를 형성한 전자부품으로, 경량화·공간 효율·설계 유연성 측면에서 전장 부품 적용에 유리

경량화

공간 효율

설계 유연성



자료 : Grand View Research

04. Next Chapter – FPCB 사업 진출

대면적 FPCB 기반 전장·반도체·로봇 등 첨단산업 적용 확대



대면적 FPCB 기반 적용 산업 확대



EV/Automotive

와이어 하네스 대체 및 배터리·BMS
적용 확대로 대면적 FPCB 수요 대응



로봇

다관절·가동부 중심의 유연 배선 적용으로
경량화 및 설계 자유도 확보





Creating a sustainable future through Reliable Technology

Appendix

- 01. 재무제표(연결)
- 02. 재무제표(별도)
- 03. 일반 현황
- 04. 관계회사 현황
- 05. DRAM 공정 로드맵
- 06.. NAND 공정 로드맵

01. 재무제표(연결)



재무상태표		단위: 백만 원			
구분	2023	2024	2025	2026.1Q	
유동자산	51,570	55,397	70,155	80,415	
비유동자산	74,827	99,512	160,349	171,075	
자산총계	126,397	154,909	230,504	251,490	
유동부채	29,533	46,835	51,335	65,742	
비유동부채	31,734	38,792	81,977	82,009	
부채총계	61,267	85,627	133,312	147,751	
지배기업 소유지분	65,130	69,283	96,721	103,267	
자본금	3,980	4,003	4,013	4,013	
자본잉여금	37,441	38,176	38,291	38,291	
기타자본	(226)	(3,283)	(3,518)	(3,406)	
기타포괄손익누계액	545	(1,152)	898	992	
이익잉여금	23,389	31,539	57,037	63,377	
자본총계	65,130	69,283	97,192	103,739	

손익계산서		단위: 백만 원			
구분	2023	2024	2025	2026.1Q	
매출액	47,361	62,217	84,445	34,871	
매출원가	31,955	40,057	50,317	23,464	
매출총이익	15,406	22,159	34,128	11,407	
판매비와 관리비	4,930	8,011	11,885	3,904	
영업이익	10,476	14,149	22,243	7,503	
영업외수익	3,632	4,952	9,476	1,133	
영업외비용	4,360	3,340	3,899	2,179	
관계기업투자이익	(611)	799	(2,296)	209	
법인세비용차감전 순이익	9,137	16,560	25,524	6,666	
당기순이익	10,761	8,911	25,560	6,340	

02. 재무제표(별도)



재무상태표		단위: 백만 원			
구분	2023	2024	2025	2026.1Q	
유동자산	50,509	55,122	51,179	61,563	
비유동자산	75,314	100,026	112,404	122,794	
자산총계	125,823	155,147	163,583	184,357	
유동부채	30,956	47,419	37,995	52,406	
비유동부채	31,734	38,792	33,974	33,429	
부채총계	62,690	86,211	71,969	85,835	
자본금	3,980	4,003	4,013	4,013	
자본잉여금	37,441	38,176	38,291	38,291	
기타자본	(226)	(3,283)	(3,518)	(3,406)	
기타포괄손익누계액	566	451	611	611	
이익잉여금	21,371	29,590	52,216	59,012	
자본총계	63,133	68,936	91,613	98,522	

손익계산서		단위: 백만 원			
구분	2023	2024	2025	2026.1Q	
매출액	46,371	61,188	83,333	27,532	
매출원가	29,087	38,308	49,055	17,587	
매출총이익	17,284	22,880	34,277	9,945	
판매비와 관리비	3,890	7,331	11,895	2,851	
영업이익	13,394	15,549	22,383	7,094	
영업외수익	3,629	4,574	4,038	1,006	
영업외비용	4,623	4,137	3,809	1,275	
법인세비용차감전 순이익	12,400	15,986	22,612	6,826	
당기순이익	11,717	8,980	22,688	6,796	

03. 일반현황



회사개요

회사명 주식회사 케이엔제이	대표이사 심 호 섭
설립일 2005년 4월 28일	상장일 2019년 10월 25일(KOSDAQ)
임직원 수 287명	주요 제품 반도체 공정용 SiC 소재 부품 제조
주소 본사 충남 아산시 음봉면 스마트산단1로 22 당진사업장 충남 당진시 송악읍 부곡공단4길 53-57	

성장연혁

Breakthrough

2022 – 2025

- 2025** • 성과공유기업 지정 (중소벤처기업부)
- 2024** • 인재육성형중소기업 지정 (중소벤처기업부)
- 2023** • 가족친화기업 선정 (여성가족부)
• 충청남도 유망중소기업 선정
• 동탄산업훈장 수훈
• 기술혁신우수기업 충남도지사 표창

Expansion

2011 – 2021

- 2022** • ISO 45001 안전보건인증 취득
- 2021** • 첨단기술·제품 확인 인증 (산업통상자원부)
- 2019** • 코스닥시장 상장
- 2016** • 제53회 무역의날 “3천만불 수출의탑” 수상 (한국무역협회)
- 2014** • 중국법인설립 (쑤저우)
- 2011** • ㈜CMS 인수합병

Foundation

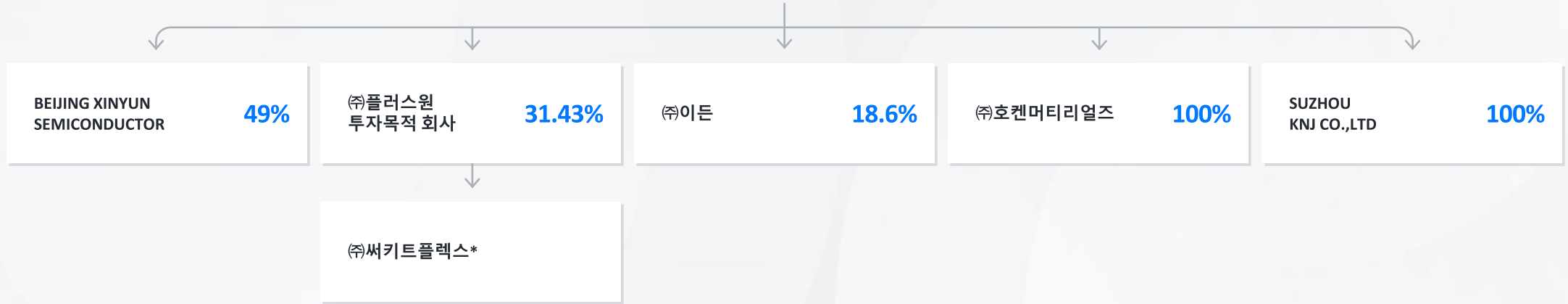
2005 – 2009

- 2009** • 기술창업선도기업 선정 (중소기업청)
- 2008** • 기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 (중소기업청)
- 2007** • 제37회 한국정밀산업기술대상 산업자원부장관상 수상 (개인,단체)
- 2006** • 벤처기업 인증 (기술보증기금)
• 기업부설연구소 인증 (한국산업기술진흥협회)
- 2005** • 케이엔제이 설립

04. 관계회사 현황



케이엔제이



05. DRAM 공정 로드맵

HBM 수요 확대에 따른 선단 DRAM 전환투자 본격화



HBM 대응을 위한
P4 중심 투자 확대



HBM3E·HBM4 대응을 위한
1b, 1c 등 선단 Tech node 비중 확대



M15X 신규 라인 및
우시 라인 전환 투자

투자구분	공급사	국가	도시	Fab명	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27		
신규 증설	삼성전자	한국	평택	P4	1c nm				1c nm									
				P5														1d nm
신규 증설	SK하이닉스	한국	이천	M16	1b nm				1b nm									
				청주														
				용인												1c nm		
신규 증설	마이크론	미국	보이시	ID1					1c nm									
				일본	히로시마													1c nm
공정 전환	삼성전자	한국	화성	L15	1y nm > 1b nm													
				L16			1z nm > 1b nm											
				P2			1d nm											1d nm
	신규 증설	SK하이닉스	한국	이천	M14		1a nm > 1c nm											
					M16	1b nm							1b nm > 1c nm					
					중국	C2	1y nm > 1a nm											
공정 전환	삼성전자	한국	평택	P3		1a nm > 1c nm												
				P4								1a nm > 1c nm						

자료: 각 사, 산업자료, 한국투자증권

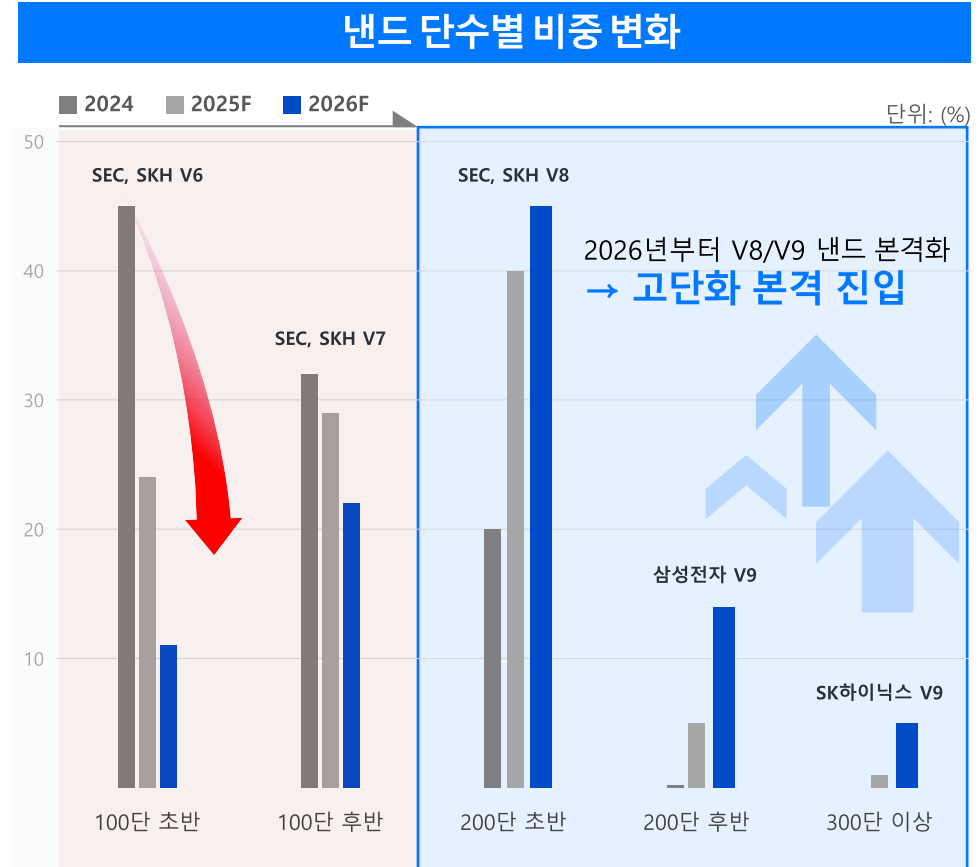
06. NAND 공정 로드맵

V9 및 300단대 NAND 전환투자 확대



낸드플래시 Tech Node 로드맵								
	2023		2024		2025		2026	
	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
삼성전자	14nm(MLC/TLC)							
	V7, 176L (TLC, QLC)	V8, 236L (TLC)				V9, 286L (TLC/QLC)		
SK하이닉스	14nm(MLC/TLC)							
	V7, 176L (TLC, QLC)	V8, 238L (TLC/QLC)			V9, 321L (TLC/QLC)			V10, 375L
솔리다임	G5, 192L FG (QLC)						G6, 240L (TLC/QLC)	
키옥시아 /SanDisk	15nm(MLC/TLC)							
	112L	BiCS6, 162L (TLC/QLC)			BiCS8, 218L (TLC/QLC)			BiCS9, 264L (TLC/QLC)
마이크론	16nm(MLC/TLC)							
	G8, 232L (TLC/QLC)			G9, 276L (TLC/QLC)				
YMTC	X3, 232L (TLC/QLC)		X4, 160L		X4, 260L		X5, 260L	
MXIC	19nm (SLC/MLC)							
	96L (TLC)							192L (TLC)

자료: Trendforce, 한국투자증권



자료: Trendforce, 한국투자증권
주석: 표시된 텍스트는 각 단수에 해당하는 제품을 생산하는 주요 기업을 의미